

第9期定時株主総会 質疑応答の要旨

株主の皆様よりいただいた主なご質問とその回答について、ご理解いただきやすいように表現の変更や加筆・修正を行った上で、記載しております。

質問内容	回答要旨
(1) 企業理念のKOKUSAI ELECTRIC Wayについて	当社グループでは、コーポレートスローガンの「技術と対話で未来を創る」を最上位の概念と位置づけ、これを基にパーパス、ビジョン、バリュー、ミッションを体系化した「KOKUSAI ELECTRIC Way」を企業理念として制定しております。当社グループにとって最重要課題である技術開発に取り組みつつ、お客様をはじめとするステークホルダーとの双方向の対話を重視し、その対話を通じて、我々の技術で未来をつくり、支えていくことを基本的な姿勢としております。
(2) 配当性向及び今後の株価について	今後の更なる株主還元に向け、連結配当性向は20%から30%程度を目安とし、加えて、ネットキャッシュがプラスに転換した後は、有利子負債の分割償還後のフリー・キャッシュ・フローの70%を配当や自己株式取得に充当することをめざしてまいります。 また、当社は、株価を意識した経営を心掛けており、株価の日々の変動についてはコメントを差し控えますが、株主様、投資家及びアナリストの皆様のご期待や懸念は意識しております。決算説明会や個別取材に積極的に対応し、株主様を含むステークホルダーに当社の企業価値を適切に理解してもらうための努力を続けていく所存です。
(3) 成膜事業における当社のマーケットシェアについて	半導体製造装置業界のトップ企業は、ほぼ全ての工程の半導体製造装置を扱われているように思いますが、当社は成膜分野に特化しており、バッチ成膜装置の分野における我々のシェアは世界トップクラス、特にバッチ ALD*対応装置、トリートメント装置は高いシェアを有しております。デバイス構造の複雑化に伴い、当社のバッチ ALD

	<p>技術が今後も多用されていくと考えており、我々の活躍できる場はますます広がっていくと期待しております。</p> <p>(注) 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます</p>
(4) 当社バッチ装置の国内市場におけるシェアについて	<p>バッチ成膜技術は最先端のデバイスで使われる技術であり、現状国内で多く使われている技術ではないため、現状国内のシェアは高いとはいえません。今後さらに微細化が進んでいく先端のデバイスにおいて、当社の活躍が光ってくるものをご理解いただければ幸いです。</p>
(5) 為替レート変動による当社業績への影響について	<p>装置の売買取引は、ほとんどが円建てのため、為替変動による業績への大きな影響はありません。ただし、海外のグループ会社では、一部、部品販売やサービス等において、現地通貨で取引を行っていることから、若干の影響はあり、2024年3月期の売上は通期で10億円程度上振れ、利益は数億円程度上振れになっております。</p>
(6) 人財の獲得(外国人技術者の採用含む)及び育成について	<p>まず、人財の確保について、新卒採用は、半導体業界が活況である等の事情もあり、計画どおり推進できております。一方、中途採用は、通常の人財紹介に加え、リテナー採用等様々な手法を用い計画を達成できるよう努力しております。</p> <p>次に、人財の育成について、入社者に対しては、当社へのエンゲージメントの維持・向上のための様々な人財育成施策及び必要な教育を行っております。</p> <p>最後に、グローバル人財の採用について、主にアジア地域における採用活動を実施・強化しております。</p> <p>人財戦略は、当社グループの将来を左右しかねない非常に重要な政策と認識しております。今後ますます人財獲得競争が厳しくなる状況の中、最大限の努力をもって優秀な人財を数多く受け入れていけるような会社になっていきたいと考えて</p>

	おります。
(7) 売上の海外比率が高いこと及び中国のカントリーリスクについて	当社の連結売上収益に占める海外の比率は、2024年3月期で88%、中国の比率は46%です。グローバルの半導体市況が少し弱く、半導体デバイスメーカーの投資が抑制されたため、相対的に中国の比率が高くなりました。今後、半導体市況が回復して、設備投資がグローバルで再開されますと、結果的に中国の占める比率は低下する見通しです。一定の地域や特定の顧客に過度に依存することは、事業運営上も好ましくないと考えておりますので、広く・多くのお客様、地域、国でビジネスができるよう取り組んでまいります。
(8) 日本と韓国の生産拠点における生産品の棲み分け、韓国生産拠点の主な仕向け先について	日本（富山）と韓国における生産比率は約3対1です。仕向け先につきましては、韓国に大手の半導体デバイスのお客様が多いことから、製品提供をスムーズに行うため、韓国の工場を活用しております。また、中国は非常に大きな市場であることから、日本だけではなく、韓国からも一定量供給できる体制としております。なお、基本的には、新規開発品や高難度品については日本から、量産展開品は韓国から提供するという棲み分けとしております。
(9) 2024年3月期第4四半期の売上利益の減少及び2025年3月期の業績予想について	2024年3月期の第4四半期の利益は第3四半期に比べて若干減少しましたが、これは、当社の売上が基本的に装置の出荷により計上されることに起因しています。お客様への納期の関係上、第4四半期の売上・利益が減少しましたが、当初の想定から大きくずれたものではありません。また、2024年3月期の売上、利益は、ともに当初の予想よりも上振れて着地しました。2025年3月期の予想は、2024年3月期の売上からの増加を見込んだ計画を策定しております。
(10) 半導体デバイスが進化する中での、半導体製造装置メーカーへの影響と対応について	デバイスの微細化や三次元化が進むことにより、構造が複雑化することは、すなわち、当社の技術を使う機会が増えることと認識しています。当社の技術を最大限生かすべく、ハードウェア、ソフ

	<p>トウェア、プロセスにおいて、トータルで装置の製品開発を続けております。</p> <p>なお、当社ではバッチALD技術及びトリートメント技術を軸に、これらの技術をさらに磨くだけではなく、お客様のデバイスに有用な新たな技術要素を取り込んだ装置を作っていく必要もあると認識しており、幅広い開発課題に取り組んでおります。</p>
<p>(11) 第3号議案の株式報酬制度の導入による変化及び制度対象を一般社員に拡大する計画の有無について。</p>	<p>当社においては、業務執行取締役、執行役員及び部長職以上の従業員に対して株式報酬を付与しております。株主様をはじめとしたステークホルダーと価値観を共有することで、経営幹部層の企業価値向上への意識が高まる効果があったと考えております。一般社員への対象拡大は、意義、他社状況、費用面等も勘案する必要があり、今後の検討課題と捉えております。</p>